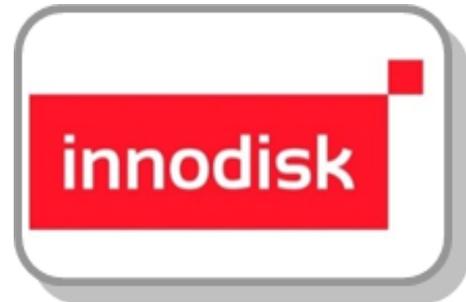


SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH * Fraunhoferstr. 9 * 85221 Dachau



Embedded Systeme — neue Trends und Lösungen

Industrie PC Hersteller haben eins gemeinsam: sie wollen alle eine lückenloses Produktportfolio anbieten, was aber die Entwicklungskosten hochtreibt und somit den Profit schmälert.

Die Lösung des Problems bieten fertige Erweiterungskarten von Innodisk.

Hohe Flexibilität bei geringer Größe kennzeichnen den Formfaktor M.2 (Next Generation Form Factor), welcher für Hersteller entwickelt wurde um mPCIe / mSATA zu ersetzen, und der sich in kompakten Industrie- und Embedded-Motherboards großer Beliebtheit erfreut.

M.2 hat mSATA-SSDs in einigen Embedded-PCs wirkungsvoll ersetzt, aber die Vorteile des M.2-Formfaktors kennzeichnet mehr als das. M.2 kann zusätzlich weitere Funktionen unterstützen.

Die Palette reicht von Kommunikationsprodukten über Display, Speicher oder Disk Array Lösungen.

Innodisk bietet M.2-Erweiterungskarten wie: SATA , Display (HDMI / DVI, LVDS), LAN, isolated CAN-Bus, Seriell (RS232 / 422 / 485), PoE und sogar AI Beschleunigungskarten.

Flexible Interface Design

- Available with both B and M key Configuration
- Supports PCIe interfaces

Various Expansions

- Offer complete expansion solutions: AI, LAN, Serial, CAN Bus, PoE, Display, SATA expansion cards

EGPV-1101
M.2 to Single HDMI/DVI-D or LVDS Module

EGPA-I201
M.2 2280 to Dual Intel Movidius Myriad X AI module

EGPC-B201
M.2 to dual isolated CANbus 2.0B/J1939 Module

EGPL-G202
M.2 to dual isolated GbE LAN module

EGP2-X401
M.2 to four RS-232/422/485 Module

FTDI Chip mit sechs neuen USB-Bridges mit PD 3.0 Power Delivery Produkten am Markt



FTDI Chip hat eine Familie von sechs neuen USB-to-UART / MPSSE (Multi Protocol Synchronous Serial Engine, SPI/I2C/JTAG master) Brückenbausteine der Reihe FT223xHP, mit implementiertem Typ C Versorgungsspannungskontroller vorgestellt. Die USB Typ C high speed Brückenbausteine verfügen über eine Spannungsversorgung nach PD 3.0

Power Delivery PD 3.0, 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A und 20V3A, Sink oder Source => Versorgung von Peripheriekomponenten durch den Host- oder Laden des Host-Computers, Ind. Temp. - 40 - +85 degC



FT232HPQ	Single Channel Serial UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C/FT1248 with Single PD Port
FT233HPQ	Single Channel Serial UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C/FT1248 with Dual PD Port
FT2232HPQ	Dual Channel Serial UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C with Single PD Port
FT2233HPQ	Dual Channel Serial UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C with Dual PD Ports
FT4232HPQ	Quad Channel Serial UART/JTAG/SPI/I2C with Single PD Port
FT4233HPQ	Quad Channel Serial UART/JTAG/SPI/I2C with Dual PD Ports

Neue ESP32- C3 - Wifi und BT 5.0 LE Combo Module



Das ESP32-C3 Modul basiert auf einem RISC-V Einkernprozessor mit maximaler Taktfrequenz von 160 MHz und verfügt über on-chip 400 KB SRAM und 384 KB ROM. Als periphere Memory Schnittstellen stehen Dual SPI, Quad SPI und ein QPI Interface zur Verfügung, welches eine direkte Verbindung zu einem externen Serial Flash Speicher ermöglicht. Leistungs- und HF Performance entsprechen dem Stand der Technik

Sicherheitsmerkmale wie secure boot, basierend auf RSA-3072, auf AES - 128 XTS basierende Flash Verschlüsselung, innovative digitale Signatur sowie auf Basis von Hash Message Authentifizierungscode (HMAC) implementierte Hardwarebeschleunigung für Verschlüsselungsalgorithmen.

⇒ ESP32- C3- MINI-1 Abmessung: **13,2 x 16,6 x 2,4 mm**

⇒ ESP32- C3- WROOM-02 Abmessung: **18,0 x 20,0 x 3,2 mm**

Das Mini -1 Modul ist in einer +85deg C und +105 deg C Variante lieferbar. Vollzertifizierung, integrierte Antenne und SW Stack sowie Entwicklungskit, erleichtern eine schnelle Implementierung.



LTE und NB-IoT: Ersatz für abgekündigte Cinterion® und Thales MC55 Anwendungen



Mit den Modulen der YC55-Familie stehen eine Reihe von Alternativen zur Nachrüstung von Anwendungen mit den Mobilfunk-Modulen Cinterion® MC55 und MC55i (Thales/Gemalto) zur Verfügung. Alle Module der YC55-Familie sind steckbar und können i.d.R. ohne Änderung der vorhandenen Hardware anstatt des bisherigen MC55(i) verwendet werden.

Das YC55-TX82 ist das jüngste Mitglied der YC55-Familie, ausgelegt für Data-Only-Anwendungen mit dem Cinterion® Mobilfunk-Modul TX82-W der Thales DIS AIS Deutschland GmbH (vormals Gemalto M2M GmbH).

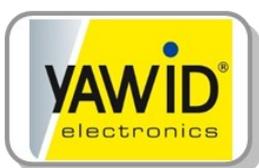
⇒ LTE Cat. M1/NB1/NB2, FDD -LTE Bänder

⇒ GSM 850,900,1800,1900 MHz, GPRS und EDGE Class 10

⇒ Region: global inkl. div. Netzbetreiber-Zulassungen

⇒ Steckerkompatibel zum MC55(i)

⇒ 3,0V Logik, 35,0x32,5x3,3 mm



CHUROD Miniatur Leistungsrelais nach DIN EN 61810

A1 Miniatur Leistungsrelais 3-10 A

Das Churod Electronics Miniaturleistungsrelais der Reihe A1 wurde speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt und zeichnet sich folgendermaßen aus

- Kompakte Abmessungen 18,2 x 10,2 x 14,9 mm
- Kontaktart 1x form A (SPST)
- 4kV Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten



CHI03 Miniatur Leistungsrelais 17 A

Das Churod CHI03 entwickelt für Industriesteuerungen bei kleinstem Platzbedarf, einem maximalen Strom sowie einer hohen mechanischen und elektrischen Stabilität.

- Abmessungen 29,3 x 12,7 x 15,3 mm
- Kontaktart 1x Form A (SPST-NO) und 1 x form C (SPDT)



Edison UVC High Power LEDs >99% Desinfektion bei Viren

Edisons High Power LEDs der EDILUV Serie eignen sich besonders für den Einsatz zur Luft, Wasser oder Oberflächendesinfektion. Die Mid-Low Power LEDs werden für Anwendungen in tragbaren Geräten adressiert.

EDILUV 5050 Mid-Power Serie

Kompakte Größe 5,0 x 5,5 mm

2W – 275nm

Deep UV LED

120 Deg Öffnungswinkel

Anwendungen: z.B. tragbare Analyse- und Desinfektionsgeräte

EDILUV 70070 High-Power Serie

Kompakte Größe 7,0 x 7,0 x 1,66 mm

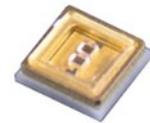
5W – 275nm

Deep UV LED

120 Deg Öffnungswinkel

Hohe Wärmeableitung

Anwendungen: Desinfektion, Sterilisation, Analyse



Innodisk OSR, System- und Datenwiederherstellung auf einem anderen Niveau

Die patentierte InnoOSR Technologie für „Ein-Klick Systemwiederherstellung“, ausgelöst über einen GPIO-Pin oder über Software Trigger. Erhältlich in allen Formfaktoren (2,5“, M.2)



Model name	2.5" SATA 3TO7	M.2 2242 3TO7	M.2 2280 3TO7	mSATA 3TO7
Interface	3rd generation SATA			
Flash type	Kioxia Industrial 3D TLC			
Capacity	32 GB - 1 TB	32 GB - 512 GB	64 GB - 1 TB	64 GB - 1 TB





SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH
 Fraunhoferstraße 9
 85221 Dachau
 Telefon: 08131-29276-0
 Fax: 08131-29276-99
 E-Mail: info@simos.de

Geschäftsführer:
 Gerhard Huber
 Benedikt Brenner

**Sie finden uns
 auch im Web:**

www.simos.de

3D pSLC CFast™ F.86 Serie für high end Industrieanwendungen

Mit der Einführung der Swissbit F-86 Serie adressiert Swissbit Anwendungsfälle für Boot-Laufwerke oder Datenspeicher, die den etablierten austauschbaren CFast™ Formfaktor erfordern. Hochwertige 3D-TLC-Flash-Technologie im pSLC-Modus, der neueste DRAM-lose Industrie-Flash-Controller und eine konsequent optimierte Firmware, machen den F-86 zu einer kosteneffizienten Lösung für industrielle Systeme oder andere Embedded-Anwendungsfälle,

CFast™ -Solid State Drive in den Abmessungen 36,5 x 42,8 x 3,6 mm



Konform mit SATA III 6Gb/s-Schnittstelle, rückwärtskompatibel zu SATA II und SATA I

Speichergrößen von 10 GB bis 160 GB, konfiguriert im 100% pSLC-Modus für hohe Schreibzyklen / Endurance (11,9 DWPD)

Ind. Temp. -40°C bis 85°C, AES-128/256, und TCG Opal

Vorteile liegen im steckbaren, kleinen Formfaktor für höchste Produktrobustheit und Datensicherheit, geringem Stromverbrauch, Datenintegrität über den gesamten Produktlebenszyklus und der langfristigen Verfügbarkeit und Swissbits Verpflichtung, Projekte und Anwendungen mit langer Lebensdauer zu unterstützen.

LineCard

